

Der MID Summit 2021

Die Plattform für MID-Technologien

Durch die MID-Technologie ist es möglich, mechanische, elektronische, thermische, strömungstechnische und optische Funktionen in dreidimensionale Schaltungsträger auf verschiedenen Materialien zu integrieren. Der neu etablierte Begriff MID ‚Mechatronic Integrated Devices‘, früher bekannt als Molded Interconnect Devices, spiegelt heute die Erweiterung der diversen Potenziale der MID-Technologie und die Perspektiven auf neue, vielversprechende Technologien wie gedruckte Elektronik und additive Fertigung wider. Branchenübergreifende Anwendungen wie elektronische Intelligenz, Energiespeicher, Sensorfunktionen und Kommunikationsfähigkeiten müssen in Zeiten des Internet der Dinge (IoT) auf engstem Raum auf jedem Material integriert werden. Für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Strukturierungs-, Metallisierungs- und Druckprozessen sind diese Randbedingungen das ideale Wachstumsmedium für Mechatronic Integrated Devices.

Die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V. fördert mit dem MID Summit 2021 die Vernetzung der Mitglieder sowie externer Interessenten. Mit dieser Veranstaltung erhalten die Mitglieder die Möglichkeit sich zu präsentieren. Der MID Summit bietet eine neue, innovative Plattform für die MID-Technologie.

Technologiefokus

Der MID Summit präsentiert innovative Technologien zum Aufbau, zur Entwicklung und zur Produktion räumlich integrierter Baugruppen.

Im Rahmen einer offenen Ausstellung, begleitender Fachvorträge und Führungen durch lokale Forschungslabors vernetzen sich Interessierte und Expert:innen aus den Bereichen Material, Entwicklung und Produktion.

Folgende Schwerpunkte werden dargestellt:

- **Gedruckte Elektronik, Antennen, Photovoltaik, Sensoren, Leuchtmittel und Aktoren**
- **Organische Elektronik**
- **Additive Fertigung**
- **2D/3D-Druck, Plasma- und chemische Beschichtungstechnologien**
- **Montage- und Verbindungstechnik**
- **Prüf-, Test- und Zuverlässigkeitsverfahren**

Ausstellung

Nutzen Sie die Gelegenheit Ihr Unternehmen oder Institut zu präsentieren. Gegen eine Unkostenpauschale von 500 € für Mitglieder (1.000 € für nicht-Mitglieder) stellen wir den notwendigen Platz für eine Table-Top-Präsentation, inklusive eines Tisches oder eine größere Grundfläche für einen Messestand, zur Verfügung. Der Standbau ist nicht inklusive. Optionale Positionen finden Sie auf der zweiten Seite des Anmeldeformulars.

Fachvorträge

Nutzen Sie den MID Summit als Plattform, um neueste Produkte, Entwicklungen und Forschungsarbeiten zu präsentieren. Über das unter <https://www.3d-mid.de/veranstaltungen/mid-summit-die-plattform-fuer-mid-technologien> hinterlegte Formular können Sie Ihre Vortrag einreichen.

Besucher:innen

Unter <https://www.3d-mid.de/veranstaltungen/mid-summit-die-plattform-fuer-mid-technologien/anmeldung-mid-summit> können Sie sich kostenfrei als Besucher:in für den MID Summit registrieren.

Auf- und Abbau

Die Halle ist am 29.09.2021 und 01.10.2021 für Auf- bzw. Abbau der Messestände zugänglich.

Kontakt

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle jederzeit gerne zur Verfügung.

Service Center 3-D MID e.V.
Fürther Str. 246b
90429 Nürnberg

Telefon: +49 911 5302-9101
E-Mail: info@3dmid.de
Internet: www.3dmid.de



Mechatronic Integrated Devices

MID SUMMIT

- **Technologien und Ausstellung**
- **Vorträge und Präsentationen**
- **Vernetzung und Diskurs**

**Halle 14 auf AEG
Muggenhofer Str. 141
90429 Nürnberg
30. September 2021**



organisiert durch
Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische Baugruppen
3-D MID e. V.

unterstützt von
FED
Fachverband für Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

FAPS

HIDRONIK

**Hahn
Schickard**

it's owl
Printed
Electronics
Franken

Agenda, Vorträge und Ausstellende

09:00 **Eröffnung des MID Summits durch Prof. Franke**

10:00 **Mitgliederversammlung 3-D MID e.V.**

12:00 **Fachgespräche & Vernetzung bei leichtem Imbiss**

12:30 **Fachvorträge Session I**

13:30 **Poster-Session aktueller Forschungsprojekte**

14:00 **Führung durch nahegelegene Forschungslabore**

15:00 **Fachvorträge Session II**

15:30 **Poster-Session aktueller Forschungsprojekte**

16:30 **Führung durch nahegelegene Forschungslabore**

17:30 **Ausklang des MID Summits**

